

1名分料金で
2人目無料

半導体デバイスにおける 低温・常温接合のポイントと今後の展望

【LIVE配信】
【アーカイブ配信】

◆日時: 2026年6月5日(金)10:30~16:30

【アーカイブ配信: 6月8日(月)~6月22日(月)】

◆会場: 自宅や職場など世界中どこでも受講可

◆聴講料: 1名につき55,000円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき49,500円(税込)

・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で55,000円(税込))

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: (国研)産業技術総合研究所 ハイブリッド機能集積研究部門 主任研究員 松前 貴司 氏

【習得できる知識】

低温・常温接合技術の主要なアプローチと接合原理、界面構造と特徴を学び、半導体デバイスへの応用事例と今後の展開について考察する。

【趣旨】

本講演では、半導体デバイスにおいて重要性が高まっている低温・常温接合技術について、基礎原理から最新の研究開発動向、ならびに実際のデバイス応用事例までを解説する。

まず、接合技術の分類や低温接合の特徴を概説した上で、表面活性化接合、親水化接合、原子拡散接合といった代表的手法について、接合原理、界面構造、装置構成、長所・短所を比較しながら説明する。

さらに、国際学会における研究動向やキープレイヤーを紹介するとともに、SOIやハイブリッドボンディングなどへの応用例を通じ、低温接合技術の社会実装の現状と今後の展望について議論する。

【プログラム】※内容を省略して掲載しております。詳細はHPでご確認ください。

1. 低温・常温接合の概論

1-1 講演者の略歴と研究活動の概要

1-2 接合技術の分類

(1)直接接合vs間接接合 (2)高温接合vs低温接合

1-3 低温接合の長所・短所

2. 表面活性化接合

2-1 接合原理

2-2 研究の歴史

2-3 界面構造

2-4 主要な研究者

2-5 装置構成

3. 親水化接合

3-1 接合原理

3-2 研究の歴史

3-3 界面構造

3-4 主要な研究者

3-5 装置構成

4. 原子拡散接合

4-1 接合原理

4-2 研究の歴史

4-3 界面構造

4-4 主要な研究者

4-5 装置構成

5. デバイスへの応用

5-1 Silicon-on-Insulator

5-2 Hybrid bonding

5-3 積層型太陽電池

5-4 MEMS封止

5-5 異種材料接合型デバイス

5-6 社会実装への課題

【質疑応答】

【LIVE配信セミナーとは?】

・本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードするか、Webブラウザから参加するかの2種類がございます。

ZOOM WEBセミナーのはじめかた (<http://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf>) をご覧ください。

・お申込み後、受理のご連絡メールをさせていただきます。一部メールが通常セミナー形式(受講券、請求書、会場の地図)になっておりますが、LIVE配信のみのセミナーです。

・お申込み後、接続テスト用のURL (<https://zoom.us/test>) から「ミーティングテストに参加」を押していただき動作確認をお願いします。

・後日、別途視聴用のURLをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時の10分前に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

・セミナー資料は前日までには、お送りいたします。タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

『半導体デバイス接合【WEBセミナー】』セミナー申込書 < LIVE配信 アーカイブ配信 >

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

 Eメール 郵送